

Agileo Automation kündigt zukünftige Erweiterung des A²ECF-SEMI-Automatisierungsframeworks mit dem SEMI-EDA-Standard (Equipment Data Acquisition) an

Die Integration des neuesten SEMI-Standards ermöglicht OEMs die Bereitstellung strukturierter Daten mit hoher Bandbreite an Halbleiterfabriken und steigert so die Effizienz und den Wettbewerbsvorteil der Fabriken

CEA Leti Innovation Days/LID World Summit, Grenoble, Frankreich, 17. Juni, 2025 – [Agileo Automation](#), ein führender Anbieter von Steuerungs- und Konnektivitätslösungen für globale Hersteller von Halbleiterausrüstung, hat die bevorstehende Integration der EDA-Standardsuite (Equipment Data Acquisition) von [SEMI](#) in sein Automatisierungssoftware-Framework [A²ECF-SEMI](#) angekündigt. Diese Integration, die die bereits enthaltenen Produkte [Agil'GEM](#) und [Agil'GEM300](#) ergänzt, wird es Herstellern von Halbleiterausrüstung ermöglichen, strukturierte Daten mit hohem Durchsatz an Produktionsanlagen zu liefern. EDA-Standards, die auf dem Erbe von [SECS/GEM](#) und GEM300 aufbauen, verändern die Gerätekommunikation und ermöglichen eine datengesteuerte Hochgeschwindigkeitsfertigung. Diese Integration wird es Wafer-Produktionsanlagen ermöglichen, ihre Prozesse durch künstliche Intelligenz (KI) zu verbessern, indem sie große Mengen zuverlässiger und umsetzbarer Daten nutzen. Mit jedem neuen Prozessknoten und der zunehmenden Nutzung fortschrittlicher Verpackungstechniken sieht sich die globale Halbleiterindustrie mit einem drastischen Anstieg der Datenkomplexität konfrontiert. Da Halbleiterfabriken zunehmend vernetzt und automatisiert werden, ist die Fähigkeit von OEM-Geräten, sich nahtlos zu integrieren und hochwertige, strukturierte Daten zu liefern, nicht länger optional – sie ist zu einem Wettbewerbsvorteil geworden. Diese Ankündigung erfolgt, nachdem das französische Unternehmen in den letzten sechs Monaten zwei wichtige Meilensteine erreicht hat, die beide mit der Entwicklung von EDA-Fähigkeiten zusammenhängen.

Im April 2024 lieferte Agileo einen digitalen Zwilling einer Anlage zur Halbleiterfertigung auf Basis von A²ECF SEMI, der einen grundlegenden Baustein des [OTPaaS](#)-Projekts (operational technology, platform as a service) darstellt, insbesondere für Anwendungsfälle im Zusammenhang mit verteilter Orchestrierung und industrieller Datenerfassung. Dieses Projekt begann vor über drei Jahren und endete im März 2025 mit der Inbetriebnahme des Demonstrators in einem Reinraum von [CEA-Leti](#). Dieser digitale Zwilling wurde entwickelt, um das Verhalten echter Anlagen zur Halbleiterfertigung originalgetreu zu simulieren und basiert auf den SEMI-Standards SECS/GEM E5, E37 und E30. Mit diesem Projekt konnte Agileo den Grundstein für eine Kommunikation mit hoher Bandbreite und hohem Volumen legen und an mehreren Anwendungsfällen zur Nutzung dieser Daten arbeiten. Das OTPaaS-Projekt wurde im Rahmen von [France 2030](#) von einem Konsortium aus führenden nationalen Industriekonzerne, kleinen und mittleren Unternehmen sowie führenden Forschungseinrichtungen geleitet.

Während der SEMI North America Standards Fall Meetings am Hauptsitz in Milpitas, Kalifornien, im November 2024 erreichten einige Anbieter, darunter Agileo und ein OEM, einen wichtigen Meilenstein: Sie führten erfolgreich die ersten Interoperabilitätstests der SEMI EDA Freeze 3-Standardsuite mit Schwerpunkt auf Konnektivität und Datenerfassung

durch. EDA Freeze 3 ermöglicht durch die Einführung von gRPC anstelle von SOAP/XML einen deutlichen Leistungssprung für Halbleitergeräte, was zu geringeren Latenzen und einem höheren Datenerfassungsdurchsatz führt.

Agileo hat EDA Freeze 2 Client- und Servertests mit Geräteherstellern durchgeführt, die EDA bereits unterstützen, und arbeitet mit diesen Early Adopters an der Integration ihrer Geräte mit A²ECF-SEMI, Agil'GEM und Agil'GEM300. Das Unternehmen wird in Kürze ein umfassendes Angebot für OEMs bereitstellen, die EDA Freeze 2 oder 3 benötigen. Angesichts der Vorteile, die EDA für Fertigungsbetriebe bietet, darunter Datensicherheit, Effizienz und strukturierte Datenorganisation, wird dies in Ausschreibungen, die Gerätehersteller berücksichtigen müssen, zunehmend gefordert.

„EDA wird die Art und Weise, wie wir Halbleiterfertigungsanlagen betreiben, grundlegend verändern und es Waferfabriken ermöglichen, diese Entwicklung zu nutzen, um höhere Erträge, schnellere Innovationszyklen und einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil in einem immer schneller werdenden Markt zu erzielen“, erklärt [Marc Engel](#), CEO von Agileo Automation. „Der Einsatz von EDA markiert einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Datensicherheit und -effizienz in Reinräumen und setzt einen neuen Standard für Halbleiterfertigungsumgebungen. Wir sind stolz darauf, maßgeblich zu diesen globalen Bemühungen beizutragen und freuen uns, OEMs in allen Marktsegmenten mit einer umfassenden und skalierbaren Produktpalette zu unterstützen.“

- Ende -

Über Agileo Automation

Seit ihrer Gründung im Jahre 2010 in Poitiers, Frankreich unterstützt Agileo Automation globale Hersteller von Halbleiteranlagen bei der Optimierung ihrer Produktionsmaschinen mit Steuerungs-, Kommunikations-, Datenerfassungs- und Testlösungen und ermöglicht so deren Einsatz in Großfabriken weltweit. Als Herzstück von Industrie 4.0 bietet Agileos A²ECF-SEMI-Framework eine robuste Grundlage für die Entwicklung von Anlagensteuerungssoftware und nutzt die Standardpakete SEMI SECS/GEM und GEM300. Als Mitglied von [SEMI](#) und der [OPC Foundation](#) trägt Agileo maßgeblich zur Entwicklung und Integration von Industriestandards wie den SEMI-Standards und der OPC Unified Architecture (OPC-UA) bei. Weitere Informationen finden Sie auf [unserer Website](#) oder folgen Sie uns auf [LinkedIn](#).